

Rahmenprogramm

Begleitende Industrieausstellung

Der Fachkongress wird durch eine begleitende Industrieausstellung und eine Posterpräsentation ergänzt. Teilnehmer des Kongresses erhalten die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen im Rahmen dieser Ausstellung zu präsentieren. Für die hierzu notwendige Anmeldung (bis 30.07.2010) und ergänzende Informationen steht Ihnen die Geschäftsstelle 3-D MID e.V. gern zur Verfügung.

- Industrieunternehmen präsentieren Produkte und Dienstleistungen zur MID-Technologie
- Forschungsinstitute informieren über aktuelle Entwicklungsarbeiten und offerieren ihre Dienstleistungen
- Mit einem MID-Technologiepfad informiert die Forschungsvereinigung über die Entwicklungs- und Technologiepotentiale

Abendveranstaltung

Das abendliche Treffen findet in der Stadthalle Fürth statt. Nach dem offiziellen Empfang bietet das festliche Abendessen Gelegenheit zu anregenden Gesprächen.

MID-Förderpreis 2010

Im Rahmen der Konferenz wird der MID-Förderpreis 2010 der Forschungsvereinigung verliehen. Mit dem Preis wird eine herausragende Entwicklungsarbeit aus dem Umfeld der MID-Technik gewürdigt.

Besichtigungen

Am Freitag, 01.10.2010, präsentieren führende Forschungsinstitute ihre MID-Entwicklungsarbeiten in ihren Labors. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung. Folgende Besichtigungen werden angeboten (Teilnahmegebühr 30,- € für Transfer und Verpflegung):

Institut 1: Universität Erlangen-Nürnberg, FAPS, DE: Elektronikproduktion

Institut 2: Universität Erlangen-Nürnberg, LKT, DE: Kunststofftechnik

Institut 3: Bayerisches Laserzentrum, DE: Lasertechnik

Organisationskomitee

A. Birkicht – HARTING AG, CH

K. Feldmann – Forschungsvereinigung 3-D MID e.V., DE

J. Franke – Universität Erlangen-Nürnberg, FAPS, DE

W. John – LPKF Laser & Electronics AG, DE

C. Goth – Forschungsvereinigung 3-D MID e.V., DE

Geschäftsstelle 3-D MID e.V.

Christian Goth

Forschungsvereinigung 3-D MID e.V.

Nordostpark 91

D-90411 Nürnberg

Telefon: +49.911.580.58.17

Telefax: +49.911.580.58.30

E-Mail: goth@3dmid.de

www.3dmid.de

Veranstaltungshinweise

Kongressort

Der Kongress findet im Konferenzzentrum (Stadthalle) der Stadt Fürth statt. Es besteht ein direkter U-Bahn-Anschluss zum Flughafen Nürnberg (Entfernung ca. 15 km) sowie zum Fürther und zum Nürnberger Hauptbahnhof.

Kongresssprachen

Kongresssprachen sind Deutsch und Englisch. Eine Simultanübersetzung der Vorträge erfolgt in Deutsch und Englisch.

Öffnungszeiten des Kongressbüros

Dienstag, 28. September 15.00 Uhr – 18.00 Uhr

Mittwoch, 29. September 08.00 Uhr – 19.00 Uhr

Donnerstag, 30. September 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Anmeldung

Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung mit Vorlage der Anmeldebestätigung. Zur Anmeldung senden Sie bitte das beiliegende Formular per Fax, Post oder E-Mail an die Geschäftsstelle 3-D MID e.V.

Teilnahmegebühren und Leistungen

Die Teilnahmegebühr ist nach Rechnungsstellung auf das dort angegebene Konto zu überweisen und schließt den Besuch von Kongress und Ausstellung, die Tagungsunterlagen sowie Mittagessen, Pausengetränke und den kostenfreien Eintritt zur Abendveranstaltung ein.

Falls die Teilnahmegebühren zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei der Kongressorganisation eingegangen sind, ist die Vorlage einer Kopie der Überweisung erforderlich.

Bei Anmeldung	bis 16.07.2010	nach 16.07.2010
Standard	620,- €	710,- €
Mitglieder 3-D MID e.V.	530,- €	620,- €
Hochschulangehörige	340,- €	420,- €

Umsatzsteuerfrei nach § 4, Nr. 22a UStG.

Stornierungen können nur in schriftlicher Form akzeptiert werden.

Es werden dann folgende Bearbeitungsgebühren berechnet:

bis zum 13. August 2010: 100,- €,

nach dem 13. August 2010: voller Preis, die Tagungsunterlagen werden zugesandt.

Haftung

Die Kongressorganisation handelt lediglich als Vermittler und übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden an Personen oder Besitz. Die Haftbarkeit für von der Kongressorganisation beauftragte Personen und Firmen bleibt davon unberührt.

Die Teilnahme am Rahmenprogramm erfolgt auf eigene Gefahr.

Mündliche Vereinbarungen sind nicht bindend, solange sie nicht schriftlich festgehalten wurden. Ort der Gerichtsbarkeit ist Erlangen, es gilt das deutsche Gesetz.

Maßgebendes Datum in allen Fällen ist der Poststempel der bei der Kongressorganisation in Nürnberg eingegangenen Post. Programmänderungen bleiben vorbehalten.

EINLADUNG



9. Internationaler Kongress

Molded Interconnect Devices

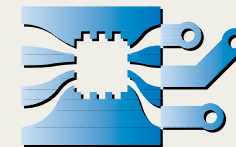
Kongresszentrum Fürth
Metropolregion Nürnberg
29. – 30. September 2010

veranstaltet von der

Forschungsvereinigung Räumliche
Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.

in Zusammenarbeit mit der

Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik – FAPS



3-D MID e.V.

Embedded Systems in MID

Spritzgegossene räumliche Schaltungsträger (Molded Interconnect Devices – MID) integrieren elektrische/elektronische, mechanische, fluidische und optische Funktionen. Die direkte Applizierung der Elektronik auf beliebig geformten thermoplastischen Substraten erfüllt die Forderung nach Miniaturisierung und erweiterter Funktionalität.

Erfolgsstory MID

Aktuelle Serienanwendungen und das zunehmende Angebot an intelligenten Fertigungslösungen unterstreichen nachdrücklich den wachsenden Markterfolg der MID-Technologie. Agile und innovative Anbieter mechatronischer Systeme, Baugruppen- und Komponentenhersteller sowie Maschinen- und Anlagenbauer nutzen konsequent die attraktiven Wachstumsraten der MID-Technik:

- MID erzielen Durchbruch in automobilen Anwendungen – auch in sicherheitsrelevanten Bereichen
- 3D-MID-Antennen revolutionieren Handy-Technologie – produziert in Millionen Stückzahlen p.a.
- Laser-Direkt-Strukturierung gewinnt renommierten HERMES Award – LPKF erhält einen der weltweit höchstdotierten Technologiepreise
- Kompetente Lieferantengruppe etabliert
- Herstellungsprozesskette vollständig verfügbar
- Fertigungsanlagen für hohen Durchsatz vorhanden

Präsentation aktueller MID-Entwicklungen

Fortschrittliche mechatronische Systeme zeichnen sich durch die intelligente Integration verschiedener Funktionen in miniaturisiertem Bau- raum aus und nutzen neueste Entwicklungen im Bereich Werkstoffe, Herstellungsprozesse sowie Fertigungstechnik:

- MID-Boom-Region Asien: Der MID-Siegeszug bei Handy-Antennen
- Erfahrungsberichte über High-Tech-Thermoplaste und kostengünstige Massen-Kunststoffe
- Stand der Wissenschaft in Material- und Prozess-Forschung
- Serienerprobte Lösungen und Konzepte zur 3D-Montage
- Rapid Prototyping für MID
- MID mit Drucktechnologien realisieren

MID 2010: Plattform für Experten und Einsteiger

Die internationale Konferenz hat sich als weltweit anerkanntes Forum der MID-Technik etabliert:

- Fachvorträge von MID-Herstellern, Anwendern und Forschungsinstituten
- Intensiver Austausch von Wissen und Erfahrung
- Direkte Information auf begleitender Fachausstellung
- Attraktives Rahmenprogramm für informelle Kontaktbildung
- Besichtigung ausgewählter MID-Forschungsinstitute

Opening Session

- 09.00** Von spritzgegossenen Schaltungsträgern zu mechatronisch integrierten Baugruppen, Prof. Dr.-Ing. J. Franke, Universität Erlangen-Nürnberg, FAPS, Vorsitzender der Forschungsvereinigung 3-D MID e.V., DE
- 09.30** Status and Prospects for MID in the Antenna Industry, Dr. E. McMillan, Molex Inc., CN
- 10.00** Verleihung des MID-Förderpreises 2010, Dr. I. Kriebitzsch, BMW AG, Vorsitzender des Forschungsbeirats, DE
- 10.15** Kaffeepause

Innovationen und Applikationen

- 10.45** 3D-MID Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Beherrschung der Fertigungsprozesse, N. Bachnak, HARTING AG, CH
- 11.10** Ein Fluid-MID auf Basis eines neuen, LDS kompatiblen 2K-Opferprozesses mit dem thermischen Management einer Power-LED als Anwendungsbeispiel, T. Leneke, Universität Magdeburg, IMOS, DE
- 11.35** New Packaging Technology Enabling Integration of Magnetics and Semiconductors in one Component, A. Pot/Dr. H. Roehm, DSM Engineering Plastics/NXP Semiconductors, NL
- 12.00** Herausforderungen der MID-Technik am Beispiel einer Anwendung aus dem Bereich der LED-Technik, K. Görmiller, Wiesaplast GmbH & Co. KG, DE
- 12.25** How MID Technology is Changing Solid State Lighting, V. Zaderej, Molex Inc., US

12.50 Mittagspause

Design und Prototyping

- 14.10** Potentialbewertung und integrative Entwicklung von MID-Bauteilen, T. Gaukstern, Universität Paderborn, HNI, DE
- 14.35** MID, flexible Leiterplatten oder PCB? Technologieauswahl basierend auf virtuellen Prototypen, Dr. T. Krebs, Mecadtron GmbH, DE
- 15.00** Neue Möglichkeiten für MID-Entwickler mittels LPKF-LDS® ProtoPainting, Dr. W. John, LPKF Laser & Electronics AG, DE
- 15.25** Herstellung funktionaler Prototypen für 3D-MID Anwendungen mittels direkter Rapid Prototyping Verfahren, C. Pscherer, Bayerisches Laserzentrum GmbH, DE
- 15.50** Kaffeepause

MID-Fertigungsverfahren

- 16.20** Neue Standards in der Zwei-Komponenten-Mikro-Spritzgusstechnologie, K. Harter, Ernst Reiner GmbH & Co. KG, DE
- 16.45** Laser Induced Selective Activation and Electroless Metallization of Standard Grade Polymer, Y. Zhang, Technical University of Denmark, DK
- 17.10** Potential Applications of Microcontact Printing for Molded Interconnect Devices, Dr. S. Gout, Université Lyon, FR
- 17.35** Erzeugung leitfähiger Strukturen durch Laserbestrahlung auf Thermoplasten, P. Putsch, pp-mid GmbH, DE

19.00 Abendveranstaltung: Empfang und Abendessen mit Programm, Stadthalle Fürth

3D-Montagetechnologien

- 08.30** Bestückungsmodul und Montageanlagen für die vollautomatisierte Serienproduktion von 3D-MID Bauteilen, T. Reissmann/J. Czabanski, XENON Automatisierungstechnik GmbH/Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG, DE
- 08.55** Bestückung dreidimensionaler Schaltungsträger mithilfe einer speziellen 3D-Substrataufnahme, M. Thamm, Häcker Automation GmbH, DE
- 09.20** 3D-Bestückung mit integrierter Robotik, M. Freiermuth, Essemtec AG, CH
- 09.45** 3D-Montage mit einem Mehrfachnutzen-Träger in einem SMT-Bestückungsautomaten, M. Pfeffer, Universität Erlangen-Nürnberg, FAPS, DE
- 10.10** Kaffeepause

MID-Herstellung und Kontaktierung

- 10.45** MID Manufacturing: Advances in Metallization Technologies Leading to Improved Yields, R. C. Retallick, MacDermid Inc., US
- 11.10** Periphere Kontaktierung von MID, U. Keßler, HSG-IMAT, DE
- 11.35** Metal-Plastic Adhesion in Electroplating of Engineering Plastics for MID Manufacturing, A. Hovestad, TNO Science & Industry, NL
- 12.00** 3D-FlexSys: Herstellung von MID durch das Tiefziehen thermoplastischer Foliensubstrate, B. Wojakowski, Laser Zentrum Hannover e.V., DE

12.20 Mittagspause

Podiumsdiskussion

- 13.30** MID-Boom-Region Asien: Wird Europa abgehängt?
Dr. E. McMillan (Molex Inc.); U. Remer (ZE mechatronic GmbH & Co. KG); N. Heining (LPKF Laser & Electronics AG); Dr. A. Brand (Continental AG);
Moderation:
Prof. Dr.-Ing. K. Feldmann (Forschungsvereinigung 3-D MID e.V.)

Drucktechnologien

- 14.30** 3D Aerosol Jet Printing – An Emerging MID Manufacturing Process, Dr. M. Hedges, Neotech Services MTP, DE
- 14.55** Thermokinetisches Auftragsverfahren Flamecon® für die Fertigung großflächiger MID, R. Süß-Wolf, LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, DE
- 15.20** Der Plasmadust Prozess: Ein innovatives Verfahren zur Metallisierung von Polymeren, Dr. E. Theophile, Reinhausen Plasma GmbH, DE
- 15.45** Kaffeepause

Materialien

- 16.15** Stoffliches Recycling von MID-Bauteilen, Prof. Dr.-Ing. A. Schmiemann, Ostfalia Hochschule, DE
- 16.40** Thermisch leitfähige Kunststoffe und ihre Vorteile für die MID-Technologie, F. Ranft, Universität Erlangen-Nürnberg, LKT, DE
- 17.05** Charakterisierung der elektromagnetischen Eigenschaften von MID-Materialien für HF-Anwendungen, C. Orlob, Universität Hannover, HFT, DE

17.30 Ende der Veranstaltung